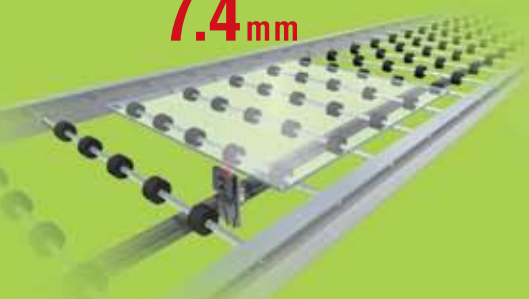


限定反射光纖元件 HPF-D028系列

限定反射型 3種型號

檢測距離

7.4mm



檢測有無玻璃基板
HPF-D028T

檢測距離

5.2mm



晶片定位
HPF-D028F

檢測距離

2.5mm



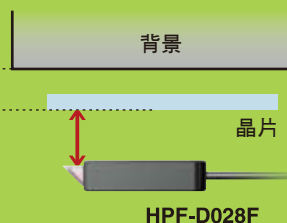
晶片切口定位
HPF-D028

■ 檢測原理



由於檢測區域僅限「受光側與投光側的檢測範圍互相重疊的範圍」，因此只能在離感測器一定距離內檢測。也不易受到被測物體顏色、或背景的影響。

■ 調整時的重點



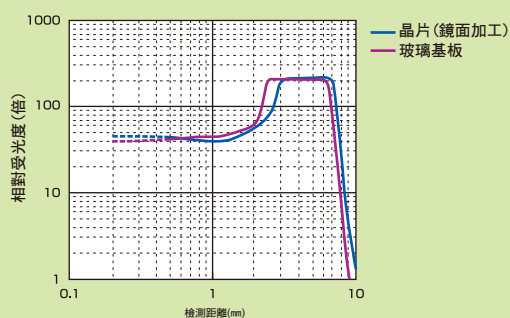
為了達到穩定的檢測，最重要的莫過於檢測晶片時，充分確保與背景的光量差。在下圖，放大器的輸出形態設定為LO(燈亮)、設定值設定為5000時，會在①約3~7mm的範圍，設定為檢測晶片。而當背景的反射率與晶片相同時也是一樣，感測器距離背景的位置約為②的10mm時，幾乎是無受光量的狀態，所以可以穩定檢測。在限定反射型時，不僅必須根據設定值進行調整，還需根據檢測個體特性進行設置也很重要。

※背景的影響會受到背景表面狀態所左右。

相對受光度特性

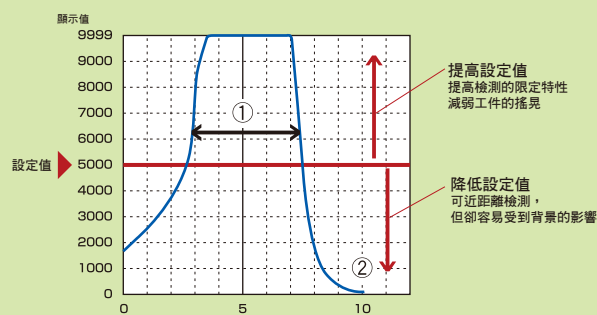
HPF-D028F

放大器：HPX-AG系列nL3



晶片檢測時的受光量特性 (代表範例)

放大器：HPX-AG系列nL3



■ 型號一覽表

類型	形狀	放大器元件HPX-AG組裝時	檢測距離(mm)	特長	彎曲R	型號
限定反射		HP3 模式	2.5±0.5	限定反射	自由切削 2m	HPF-D028
		HP3 模式	7.4±1.6			HPF-D028T
		HP3 模式	5.2±1.6			HPF-D028F

■外型圖

HPF-D028

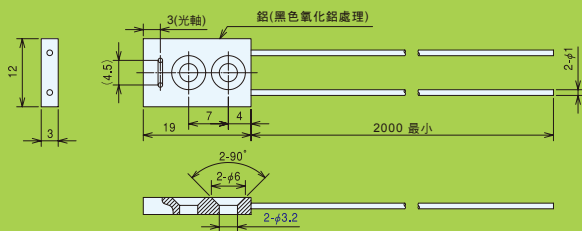
R15

-30~+70℃

2.5±0.5mm

自由切割

CAD File No.
HP-0023



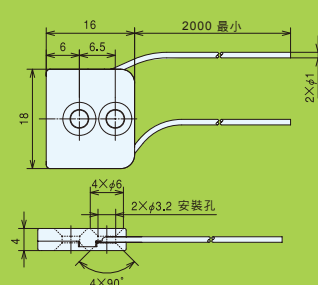
HPF-D028T

R15

-30~+70℃

7.4±1.6mm

自由切割



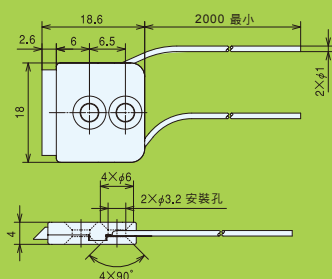
HPF-D028F

R15

-30~+70℃

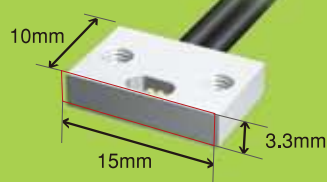
5.2±1.6mm

自由切割



■相關產品

- 薄型光纖元件，可在自動機臂等限制安裝的部位，檢測晶片。



HPF-D045LF

● 檢測視孔的玻璃基板

透過檢測玻璃基板時，可使用偏光、反射型光纖，亦可防止視孔、工件的直接反射光。光穿透玻璃基板2次，可確保保光量差，使檢測穩定。

※如果視孔的材質是樹脂，可能造成偏光混亂，無法穩定檢測。

HPF-R001



⚠ 使用上的限制

本產品的開發、設計、製造係以一般機器的使用為前提。
尤其是使用於以下需要安全性的用途時，必須實施失效安全設計、冗長設計以及定期檢查等，務必顧及器材整體的安全性後，再行使用。

- 以保護人體為目的之安全裝置
- 運輸機器的直接控制（行駛/停止等）
- 飛機
- 航太機器
- 核能機器
- 等

嚴禁將本產品用於會直接波及人命的用途上

欲洽詢本商品時，請聯絡本公司各地據點或代理店。

Yamatake Corporation 台灣山武計裝股份有限公司

台北總公司
(10448) 台北市中山區中山北路二段44號9樓 Tel: (02)2521-6800 Fax: (02)2521-2728
高雄支店
(80052) 高雄市中正三路2號13樓A室 Tel: (07)238-2758 Fax: (07)238-2757
台南營業所
(70054) 台南市民生路2段307號18-2室 Tel: (06)229-6399 Fax: (06)229-2696
新竹營業所
(30080) 新竹市金山二十三街18巷1號 Tel: (03)564-3451 Fax: (03)567-0639

[注意] 本公司保留對本資料記載的內容在未經公告的情況下進行變動的權利，敬請見諒。